公司代码:688019　　公司简称:安集科技

安集微电子科技(上海)股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在安集微电子科技(上海)股份有限公司 2025 年年度报告(以下简称“本报告”)中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的利润分配预案及公积金转增股本预案为：

公司 2025 年度拟以实施利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2026 年 4 月 14 日，公司总股本为 174,994,396 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 87,497,198.00 元(含税)，占母公司当年实现可分配利润比例约 13.68%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 11.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	安集科技	688019	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨逊	冯倩
联系地址	上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5	上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5
电话	021-20693346	021-20693346
传真	021-50801110	021-50801110
电子信箱	IR@anjimicro.com	IR@anjimicro.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司 20 多年来始终围绕液体与固体表面处理和高端化学品配方的核心技术并持续专注投入，在集成电路化学机械抛光液领域、高端功能性湿电子化学品和电化学沉积领域持续布局，使中国在该领域拥有了自主供应能力，并在国际市场上崭露头角。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，具备了引领特定新技术的能力。

在化学机械抛光液板块，公司致力于实现全品类产品线的布局和覆盖，旨在为客户提供覆盖前道晶圆制造及后道先进封装应用领域的全品类一站式解决方案和全方位服务。公司化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、金属栅极抛光液及衬底抛光液等多个产品平台。同时，公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台，支持客户对于不同特色制程的需求，定制开发用于新材料、新工艺、新应用的化学机械抛光液。

在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域，致力于攻克领先技术节点难关，并基于产业发展及下游客户的需求，在不断提升技术与产品水平的同时积极拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及整体解决方案。目前，公司功能性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液等产品。

在电镀液及添加剂产品板块，公司持续加强集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，产品覆盖应用于集成电路制造的大马士革工艺铜电镀液及添加剂、应用于先进封装领域的铜、镍、锡银等电镀液及添加剂以及硅通孔(TSV)电镀液及添加剂。目前，先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售，应用于凸点、重布线层(RDL)、异质集成技术；集成电路制造领域的大马士革工艺铜电镀液及添加剂已进入量产阶段，实现销售，先进封装锡银电镀液及添加剂以及硅通孔电镀液及添加剂开发及验证按计划进行。

公司产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片，并已进入众多半导体行业领先客户的主流供应商行列。

同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，公司建立并持续强化核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。

2.2 主要经营模式

1、采购模式

公司制定了《采购管理程序》和采购管理内部控制流程，并制定了《采购流程》《供应商管理流程》《供应灾难恢复程序》等标准作业程序。

以原、辅材料和包装材料为例，公司的一般采购主要流程如下：

①研发中心提出材料开发需求，供应链部门负责开发供应商，并由供应商管理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司合格供应商，供应链部门负责建立并维护《合格供应商目录》。公司供应商管理小组由供应链部门、研发中心、质量部、生产运营部等部门人员组成。

②需求部门提出采购申请，并按照公司审批政策得到合适的批准后提交供应链部门，供应链部门负责管理订单执行，质量部负责采购来料检验管理，仓库负责采购入库管理。

③供应链部门按照采购合同/订单获取发票、整理入库及验收等付款凭证后提交财务部申请付款审批流程。

④财务部按照采购合同/订单约定负责采购应付款管理。

2、研发模式

公司始终围绕自身的核心技术，以自主研发、自主创新为主，形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时，公司与高校、客户等外部单位建立了良好的合作关系，积极开展多层次、多方式的合作研发。公司的研发目标一方面紧跟随行业内的技术发展路线图，研发适应产业需求的产品平台；另一方面系基于下游客户的需求，针对性研发满足客户需求的产品。由于从开始研发到实现规模化销售需要较长的时间，公司与技术领先的客户合作开发，有助于了解客户需求并为其开发创新性的解决方案。

公司制定了《研发管理制度》，并建立了研发管理内部控制流程，涵盖研发计划、研发立项、研发过程跟进和费用核算管理、专利申请和取得等环节。公司产品研发及产业化的一般路径主要包括项目论证、研发 Alpha 送样、Beta 送样试生产、商业化(规模化生产)，持续改进等五个阶段。

3、生产模式

公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流。当产品通过客户评价和测试后，销售部会根据客户的产品订单及对于客户使用需求的预测制定滚动出货预测，生产运营部根据年度/月度生产计划、滚动出货预测和库存情况制订具体的生产计划、安排库存。具体而言，生产运营部每年组织各相关部门，根据排产计划编制年度生产计划及月度生产计划。生产运营部会定期进行集体评审，根据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的每周生产计划，以确保生产计划满足销售合同以及生产产能的要求；生产运营部组织各相关部门、各产品线负责人召开生产调度会，对生产计划的执行情况进行评审，以确保充分沟通可能影响生产计划交更的各种因素，及时调整生产计划(如及时关闭停工订单)，以确保计划调整的及时性及有效性。

公司已经掌握了化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂、部分品类的研磨原料生产中的核心技术，通过合理调配机器设备和生产资源组织生产。

4、销售模式

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，销售主要采用直接面对终端客户的直销模式。公司在开拓新客户或在原有客户推广新产品时，首先要根据客户的需求进行认证测试，包括产品性能、可靠性、稳定性等多方面测试，认证测试周期一般较长。公司在通过下游客户认证后，客户直接向公司下达采购订单，公司按要求直接向客户发货。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

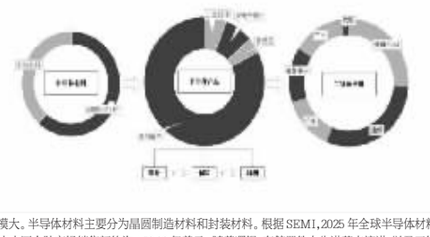
公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准，公司所处行业为半导体材料行业。

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，是半导体产业的基石和推动集成电路技术创新的引擎，对半导体产业发展起着重要支撑作用，与下游半导体市场的发展紧密相关。受益于半导体产业长期发展趋势，全球半导体材料市场规模保持增长态势，且制造更先进技术节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成技术需要更多的工艺步骤，带来更高的晶圆制造材料和封装材料消耗需求。

①半导体材料行业概况

材料和设备是半导体产业的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。

半导体材料是半导体产业的重要支撑



第一，产业规模大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。根据 SEMI，2025 年全球半导体材料市场销售额 700.00 亿美元，其中中国大陆市场销售额约为 150.00 亿美元。随着逻辑、存储器件向先进节点演进，以及三维集成和先进封装需求的爆发，倒逼上游核心技术突破，新材料与新架构正成为推动新器件与新工艺发展的关键。根据 SEMI 预测，全球半导体材料市场规模将于 2027 年突破 800.00 亿美元。

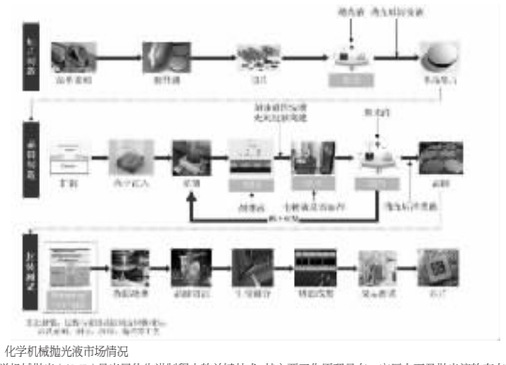
第二，细分行业多。半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业链环节，其中晶圆制造材料包括硅片、光掩模、光刻胶、光刻胶辅助材料、工艺化学品、电子特气、抛光液和抛光垫、靶材及其他材料，封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、包封材料、芯片粘结材料及其他封装材料，每一种大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品，细分子行业多达上百个。

第三，技术门槛高、研发投入大、研发周期长。由于半导体材料尤其是晶圆制造材料在集成电路芯片制造中扮演着重要的角色，甚至部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向，因此下游客户对于产品的要求极为苛刻，在上线使用前需要长周期的测试论证工作，并且上线使用后也会通过较长周期逐步上量。加之产品在能够进入测试论证阶段之前需要经历长时间、高难度的研发阶段，研发过程中需要大量的研发投入。

②公司主要产品所属细分行业情况

在半导体特别是集成电路制造过程中，晶圆表面状态及洁净度是影响晶圆优良率和器件质量与可靠性的最重要因素之一，化学机械抛光(CMP)、湿法清洗、刻蚀、电化学沉积(电镀)等表面技术起到非常关键的作用。公司围绕液体与固体对底表面的微观处理技术和高端化学品配方核心技术，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，成功搭建了“化学机械抛光液－全品类产品矩阵”、“功能性湿电子化学品－领先技术节点多产品线布局”、“电镀液及其添加剂－强化及提升电镀高端产品系列战略供应”三大具有核心竞争力的技术平台。目前，公司技术已涵盖集成电路制造中的“抛光、清洗、沉积”三大关键工艺，产品组合可广泛应用于芯片前道制造及后道先进封装过程中的抛光、清洗、刻蚀、沉积等关键循环重复工艺及衍接各工艺步骤的清洗工序。

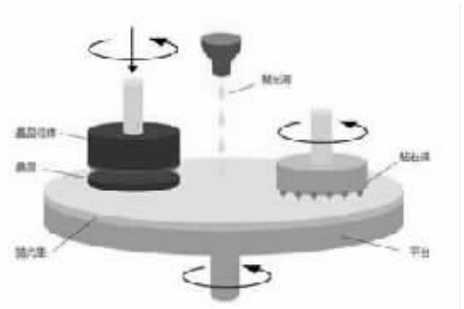
公司主要产品在芯片制造及先进封装领域的关键循环重复工艺中多次应用



● 化学机械抛光液市场情况

化学机械抛光(CMP)是半导体先进制程中的关键技术，其主要工作原理是在一定压力下及抛光液的存在下，被抛光的晶圆对抛光垫做相对运动，借助纳米磨料的机械研磨作用与各类化学试剂的化学作用之间的高度有机结合，使被抛光的晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求。根据不同工艺制程和技术节点的要求，每一片晶圆在生产过程中都会经历几道甚至几十道的 CMP 抛光工艺步骤。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 工艺是通过表面化学作用和机械研磨的技术结合来实现晶圆表面微米/纳米级不同材料的去除，从而达到晶圆表面的高度(纳米级)平坦化效应。CMP 已成为 0.35μm 以下制程不可或缺的平坦化工艺。

CMP 工艺原理图



随着制程节点的进步，多层布线的数量及密度增加，CMP 工艺步骤增加，CMP 技术越来越重要，其对后续工艺良率的影响越来越大。例如 14 纳米技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺步骤数将由 180 纳米技术节点的 10 次增加到 20 次以上，而 7 纳米及以下技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺步骤数甚至超过 30 次。此外，更先进的逻辑芯片工艺可能会要求抛光新的材料，为抛光液带来了更多的增长机会。同样地，对于存储芯片，随着由 2D NAND 向 3D NAND 演进的技术变革，也会使 CMP 工艺步骤数近乎翻倍，带动了钨抛光液及其他抛光液需求的持续快速增长。此外，先进封装技术的应用使 CMP 从集成电路前道制造环节走向后道封装环节，在如硅通孔(TSV)、混合键合(Hybrid Bonding)等工艺中得到广泛应用。

化学机械抛光液在 CMP 技术中至关重要，在抛光材料中价值占比超过 50%，其耗用量随着晶圆产量和 CMP 平坦化工艺步骤数增加而增加。根据应用的不同工艺环节，可以将抛光液分为硅衬底抛光液、铜及铜阻挡层抛光液、钨抛光液、介质材料抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液以及用于先进封装的硅通孔(TSV)抛光液等。抛光液特点为种类繁多，即使是同一技术节点、同一工艺段，根据不同抛光对象、不同客户的工艺技术要求也有不同配方。

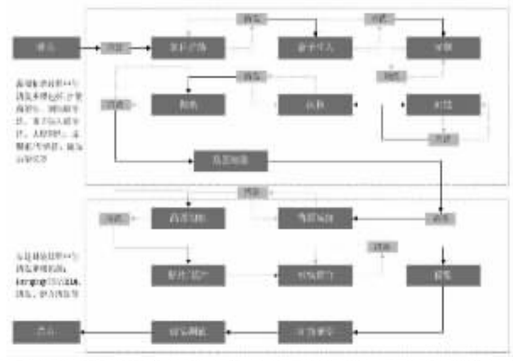
根据 TECHCET，2025 年全球半导体 CMP 抛光材料(包括抛光液和抛光垫，其中抛光液占比近 60.00%)市场规模为 38.00 亿美元，2026 年预计增长 10.3%至 42.00 亿美元。随着 AI 驱动，人工智能需求推动半导体产业发展以及先进技术节点、新材料、新工艺的应用需要更多的 CMP 工艺步骤，TECHCET 预计 2025-2030 年全球半导体 CMP 抛光材料市场规模复合增长率为 8.80%。

● 湿电子化学品市场情况

湿电子化学品是在清洗、刻蚀等多个微电子/光电子湿法工艺环节中使用的各种高纯度电子化学材料的统称，其生产涉及的核心工艺包括分离纯化、分析检测、混配及包装运输技术等，具有较高的技术壁垒。湿电子化学品主要分为通用性湿化学品和功能性湿化学品，其中通用性湿化学品主要包括主体纯度大于 99.99%、杂质含量低于 ppm 级别的酸类、碱类、有机溶剂类及其他类产品；功能性湿化学品指为满足湿法工艺中特殊工艺需求，通过复配工艺制备的配方类或复配类化学品，主要包括各类刻蚀液、清洗液及光刻胶配套试剂(剥离液、稀释剂、去边剂、显影液)等。不同于混合使用的通用湿化学品可以由半导体制造企业自己混配使用，功能性湿化学品需要由电子化学品生产企业进行研发和生产，以特定的产品形式供应给半导体制造企业使用。

公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用高端功能性湿电子化学品领域，产品涉及清洗液、剥离液和刻蚀液。清洗液用于半导体制造的清洗工艺，去除微粒、金属或离子型导电污染物及有腐蚀作用的无机、有机污染物等，根据其应用工艺不同，清洗液可分为化学机械抛光(CMP)后清洗液、铝工艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液、HKMG 假栅去除后清洗液、封装工艺用去溢料清洗液等。为最大限度地减少杂质对芯片良率的影响，当前的芯片制造流程在光刻、刻蚀、离子注入、沉积、抛光等重复性工序后均设置了清洗工序，清洗步骤数量约占所有芯片制造工序步骤的 30%以上，是所有芯片制造工艺步骤中占比最大的工序，而且随着技术节点的推进，清洗工序的数量和重要性将继续提升，在实现相同芯片制造产能的情况下，对清洗液的需求量也将相应增加。光刻胶剥离液是在曝光显影及后续工艺后去除硅片上光刻胶所用的试剂，光刻胶在经过湿法刻蚀、干法刻蚀、离子注入等不同工艺后不易被去除，要求剥离液对光刻胶有较强的溶解性能。半导体制造工艺应用的刻蚀技术主要包括湿法刻蚀和干法刻蚀两大类，刻蚀工艺用到的湿化学品为刻蚀液。

清洗和刻蚀是半导体制造过程中重要的工艺环节



湿电子化学品的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响，随着集成电路技术的不断发展，工艺复杂性和技术挑战不断增加，对湿电子化学品的杂质含量、颗粒数量、清洗去除能力、刻蚀选择性、工艺均匀性、批次稳定性与一致性等的管控要求越来越高。此外，由于新结构、新器件和新材料的不断引入，主流芯片制造厂商间的差异性也越来越大，对于功能性湿电子化学品来说，满足客户的定制化需求也成为未来发展的重要趋势。根据 TECHCET，2025 年全球半导体湿电子化学品市场规模将增长 6.00%至 54.40 亿美元。受益于芯片技术节点进步及全球芯片产能的持续增长，TECHCET 预计 2024-2029 年全球半导体湿电子化学品市场规模复合增长率约为 6%。

● 电镀液及添加剂市场情况

电化学沉积(电镀)技术作为集成电路制造的关键工艺技术之一，是实现金属互连的基石，主要应用于集成电路制造的大马士革铜互连电镀工艺和后道先进封装凸块(Bumping)、重布线层(RDL)等电镀工艺以及硅通孔(TSV)电镀液及添加剂。随着晶体管尺寸不断缩小，进入 130nm 制程以后，铝互连工艺已经不能满足集成电路集成度、速度和可靠性持续提高等需求，铜已逐渐取代铝成为金属互连的主要材料。由于铜很难进行干法刻蚀，因此传统的金属互连工艺已不再适用，拥有镶嵌工艺的镀铜技术成为铜互连的主要制备工艺，业界也称为大马士革铜互连工艺。大马士革铜互连工艺在 8 英寸以上晶圆、130nm 以下芯片制造中得到广泛应用。

在铜互连电镀工艺中，将带有扩散阻挡层和籽晶层的芯片浸没在含有添加剂的高纯电镀液中，用电镀工艺填充已经刻蚀好的互连穿孔(Via)和槽隙(Trench)。其中铜互连电镀添加剂包括加速剂、抑制剂及整平剂，在电镀工艺中起到关键作用，通过不同组分相互作用，实现从下到上填充效果以及镀层晶粒、外观及平整度。

除芯片制造铜互连工艺外，电镀液及添加剂还应用于 Bumping、RDL、TSV 等先进封装工艺。TSV 技术的核心是在晶圆上打孔，并在硅通孔中进行镀铜填充，从而实现晶圆的互联和堆叠，在无需继续缩小芯片线宽的情况下，提高芯片的集成度和性能。和芯片制造铜互连工艺相比，TSV 电镀的尺寸更大，通常需要更长的沉积时间、更高的电镀速率以及多个工艺步骤，铜互连电镀液及添加剂成本占 TSV 工艺的总成本比重也更高。

目前半导体电镀已经不限于铜线的沉积，还有锡、锡银合金、镍、金等金属，但是金属铜的沉积依然占据主导地位。铜导线可以降低互联阻抗，降低器件的功耗和成本，提高芯片的速度、集成度、器件密度等。随着先进逻辑器件技术节点带来的互连层的增加，先进封装对重新布线层和铜柱结构应用的增加，以及广泛运用铜互连技术的半导体器件整体增长，带动了电镀液及其添加剂市场的增长。根据 TECHCET，2025 年全球半导体电镀化学品市场规模将增长至 13.81 亿美元，较 2024 年增长 9.30%。随着先进封装应用以及高性能计算、人工智能等应用带来先进逻辑器件中金属互连密度的提升，TECHCET 预计 2024-2029 年全球半导体电镀化学品市场规模年复合增长率将达到 7.70%。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立之初就将自己定位为以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料供应伙伴，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，公司开始建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，保障长期供应的可靠性。公司成功搭建了“化学机械抛光液－全品类产品矩阵”、“功能性湿电子化学品－领先技术节点多产品线布局”、“电镀液及添加剂－强化及提升电镀高端产品系列战略供应”及“核心原材料建设－提升自主可控战略供应能力”具有核心竞争力的“3+1”技术平台及应用领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，并且拓展和强化了电化学沉积领域的技术平台，产品覆盖多种电镀液及添加剂。通过对上游核心原材料的持续深入研发，从性能优化、寻找开发新产品的技术可行性等方面进一步提升产品竞争力，获得更多合作机会的可能。

公司经过多年以来的技术和经验积累、品牌建设，凭借扎实的研发实力及成本、管理和服务等方面的优势，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。公司持续专注投入，已成功打破了国外厂商的垄断并已成为中国大陆众多半导体行业领先客户的主流供应商。随着“立足中国，服务全球”战略的推进，公司研发创新能力得到海外更多用户的认可。报告期内公司海外市场拓展在按计划稳步开展。根据 TECHCET 公开的全球半导体抛光液市场规模测算，最近三年公司化学机械抛光液全球市场占有率分别约 8%、11%、13%，逐年稳步提升，已跻身全球化学机械抛光液主流供应厂商行列。公司功能性湿电子化学品已在全球市场崭露头角，根据 TECHCET 全球半导体功能性湿电子化学品市场规模测算，2025 年公司功能性湿电子化学品全球市场占有率约为 6%。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025 年全球半导体产业呈现出由 AI 驱动的结构性变革。根据 WSTS，从市场结构看，逻辑芯片和存储芯片成为增长双引擎，其中逻辑芯片营收预计同比增长 38.80%，存储芯片营收同比增长 39.00%。从应用驱动看，AI 基础设施支出大幅增长，2026 年全球 AI 基础设施支出预计达 4,500.00 亿美元，其中推理算力占比首次超过 70%，推动 GPU、HBM 及高速网络连接的强劲需求。

先进封装技术成为后摩尔时代提升芯片性能的关键路径。2025 年，台积电持续扩大 CoWoS 产能，并加速推进共封装光学(CoPoS)技术研发；多家国内封测企业在先进封装领域进展显著，建成先进封装产能并实现量产。Chiplet 技术虽面临良率挑战和标准化进程，但在高性能计算和数据中心领域已成为突破光罩极限的必然选择，UCIe 3.0 规范的发布进一步推动多芯片设计成为主流策略。

中国半导体产业规模现出强劲韧性和自主化加速态势。2025 年前 11 个月，我国集成电路出口同比增长 25.60%至 1.29 万亿元。SEMI 预测，到 2028 年中国在主流半导体制造产能中的份额将达到 42.00%，有望出现数家世界级平台型半导体企业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,038,433,221.10	3,451,756,060.58	45.97	2,603,401,095.73
归属于上市公司股东的净资产	3,530,948,564.12	2,700,956,681.01	30.73	2,124,045,086.38
营业收入	2,504,217,940.48	1,835,015,178.35	36.47	1,237,871,129.22
利润总额	849,127,969.50	567,624,257.39	49.59	440,422,480.51
归属于上市公司股东的净利润	783,648,337.86	533,643,641.69	46.85	402,733,766.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	696,553,465.49	526,270,031.60	32.36	322,000,921.08
经营活动产生的现金流量净额	439,774,055.91	493,210,493.99	-10.83	336,234,683.53
加权平均净资产收益率(%)	25.18	22.18	增加 3.00 个百分点	21.47
基本每股收益(元/股)	4.66	3.18	46.54	2.42
稀释每股收益(元/股)	4.63	3.18	45.60	2.42
研发投入占营业收入的比例(%)	17.76	18.13	减少 0.37 个百分点	19.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	545,233,664.76	596,169,444.99	670,672,519.03	692,092,311.70
归属于上市公司股东的净利润	168,825,875.37	206,808,561.76	232,687,171.03	175,326,729.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,725,367.05	195,016,891.23	180,749,287.44	159,061,919.77
经营活动产生的现金流量净额	57,645,086.75	187,462,130.24	30,204,547.96	164,462,290.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,747
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,331
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
Anji Microelectronics Co. Ltd.	11,943,281	51,754,217	30.70	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	19,169,859	24,094,637	14.29	0	无	0	其他
全国社保基金一一零组合	2,013,373	3,634,467	2.16	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	726,861	2,677,133	1.59	0	无	0	其他
上海大辰科技投资有限公司	42,998	2,300,000	1.36	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,694,597	1,694,597	1.01	0	无	0	其他
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	-1,101,830	1,489,036	0.88	0	无	0	其他
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	1,291,564	1,353,303	0.80	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,059,241	1,346,466	0.80	0	无	0	其他
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,124,324	1,124,324	0.67	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			Anji Cayman 与上述其他股东无关联关系或一致行动关系，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

存托凭证持有人情况

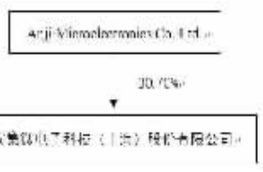
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 250,421.79 万元，同比增长 36.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 78,364.83 万元，同比增长 46.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 69,655.35 万元，同比增长 32.36%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2026 年 4 月 14 日

证券代码:688019　证券简称:安集科技　公告编号:2026-023

安集微电子科技(上海)股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1.实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]561 号)的同意，公司以简易程序向特定对象发行 A 股普通股股票 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元，实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，实际到账金额为人民币 206,546,218.90 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。

以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2023年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年3月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	207,136,218.90
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	3,517,145.62
二、募集资金净额	203,619,073.28
减:	
以前年度已使用金额	144,136,855.21
本年度使用金额	50,763,780.33
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出	15,664.72
加:	
募集资金利息收入	4,280,857.48
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额	12,983,630.50

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1555 号)的同意，公司向不特定对象发行 8,305,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额共计人民币 830,500,000.00 元，扣除总发行费用人民币 13,891,095.27 元，实际募集资金净额为人民币 816,608,904.73 元，实际到账金额为人民币 823,610,000.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了毕马威华振验字第 25000344 号验资报告。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年4月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	830,500,000.00
减:直接支付发行费用	13,891,095.27
二、募集资金净额	816,608,904.73
减:	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	435,886,549.52
现金管理金额	362,130,000.00
银行手续费支出	2,475.33
加:	
募集资金理财产品收益、利息收入	2,529,930.09
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金账户余额	21,119,809.97

二、募集资金管理情况

(一)以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2023 年 3 月 31 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“募集资金专项监管协议”)。

以简易程序发行监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照以简易程序发行监管协议履行。

以简易程序向特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称		2023年以简易程序向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023年3月29日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态(注)
安集微电子科技(上海)股份有限公司	招商银行上海天山支行	121908362710655	13,991.67	使用中
安集微电子科技(上海)股份有限公司	中信银行上海北外滩支行	8110201013601607827	11,653,219.22	使用中
安集微电子科技(上海)股份有限公司	宁波银行上海张江支行	70120122000553395	56,968.50	使用中
宁波安集微电子科技有限公司	招商银行上海天山支行	121928700910655	1,259,451.11	使用中
合计			12,983,630.50	

注:上述账户均已于 2026 年 4 月完成注销。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和